

无锡芯朋微电子股份有限公司

关于 2026年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，提出落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神，无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月14日发布了《2026年度提质增效重回报行动方案》（以下简称“行动方案”），为公司2026年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向，现将行动方案进展半年度评估情况报告如下：

一、 聚焦主营业务，提升产品核心竞争力

公司成立21年来始终专注于功率集成电路的研发、销售，以自主创新为经营核心宗旨，为客户提供高效能、低功耗、品质稳定的功率集成电路产品，推动整机的能效提升和技术升级。公司主要产品覆盖了功率芯片的大部分技术种类，产品应用市场覆盖了家用电器、标准电源以及工业设备等重点领域。报告期内，公司本着以研发创新为发展基石，持续地、有计划地推进公司自主研发，2026年上半年公司研发费用投入14,125.47万元，占公司营业收入的比例为21.24%。

2025年以来，公司坚持“功率系统整体解决方案”的相关多元化战略，DC-DC、Driver、Power Module 等产品线新品持续推出，公司在多项新技术领域取得丰硕成果，包括内嵌数字控制的集成 Buck/Boost/高压隔离半桥芯片、内嵌数字算法的 BLDC 电机驱动芯片、功能安全 ASIL-D 车规主驱芯片、车载 LED 大灯用低纹波调光 BUCK 控制器芯片、多协议兼容的环路内置集成快充协议芯片等产品陆续量产。报告期内，公司持续推进新产品线拓展，扩大下游行业应用范围。公司新品类产品（DC-DC、Driver、Digital PMIC、PowerDevice、Power Module），除器件（含晶圆MOS类）受成本策略调整影响而同比下滑之外，其他品类均显著增长。其中，Power Module系列，2026年1-6月营业收入同比增长超过2倍，具体产品包括集成电感的CubeSiP专利技

术的DC-DC电源模块、内置高压半桥驱动和保护的电机驱动模块以及集成SiC器件和半桥电机驱动模块IPM，公司核心技术正在从硅基芯片级高集成技术，延展至涵盖宽禁带器件异质集成和全维封装的系统级高集成模块产品领域。

二、 持续完善投资者回报机制

公司高度重视股东的投资回报，努力为股东创造长期可持续的价值。自2020年在上海证券交易所科创板上市以来，公司积极实施现金分红并开展回购，增强投资者信心，推动公司股价同公司价值增长匹配。截至2026年6月30日，公司实施3次股份回购，回购金额为19,834.09万元（不含交易佣金手续费等交易费用）；公司共计现金分红25,927.37万元。2026年上半年，公司回购和分红具体情况如下：

2026年6月9日，公司2025年度利润分配方案顺利实施完成，向全体股东每股派发现金红利0.45元（含税），共派发现金红利总额为5,893.06万元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润31.63%。

未来公司将统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，为股东带来长期的投资回报，持续增强广大投资者的获得感。

三、 持续加强募投项目管理，提升科技创新能力

2022年3月，公司披露了定增预案，募集资金将用于“新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目”、“工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目”和苏州研发中心的建设、实施。

近年来公司重点投入研发的工业应用领域，2025年，公司作为行业首家完成计算服务器一次电源、二次电源到三次电源的全链路产品布局的企业，十余款面向AI计算能源领域的核心新品在2026年已陆续进入量产，包括面向800V HVDC系统的1700V SiC辅源、隔离驱动、SiC/GaN驱动等芯片、兆赫兹开环DCX控制器、全集成数字硬开关全桥控制器、8/12/16多相VRM、70/90A Cu-Clip DrMOS、eFuse、PoL等高性能功率产品，并继续加大投入以满足越来越多高算力服务器客户对电源转换效率、稳定性及高密度不断进化的要求，公司在计算能源方向的研发强度大幅提升。公司持续通过新品拓展，加速成长为客户的电源和电机系统提供一站式“Power System Total Solution”

供应商，大幅提升新品推广效率，通过为客户创造价值，提高客户粘性。

四、 完善公司治理结构

2026年上半年，公司持续对标《公司法》《上市公司章程指引》及科创板最新监管法规要求，在2025年完成取消监事会、强化审计委员会职能的治理架构基础上，持续迭代完善配套内部管理制度：修订出台《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》，同步复盘审计委员会、关联交易、对外担保等治理制度执行适配性，巩固治理架构运行稳定性。公司将密切关注法律法规和监管政策的调整，持续更新完善公司内部管理制度，提升规范运作水平和风险防控能力。

2026年上半年，公司董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责。董事、高级管理人员积极参与了“上市公司财务规范运作重点关注事项专题培训”、“江苏上市公司董事会秘书专题培训”、“无锡上市公司合规发展培训”等监管部门举办的培训，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作。

五、 强化管理层与股东的利益共担共享约束及强化“关键少数”的责任

公司自2020年在上海证券交易所科创板上市至今，先后实施了4次限制性股票激励计划、1次员工持股计划的股权激励措施。2026年上半年，公司完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件核验工作，确认符合归属条件股份数量2,282,500股，并顺利完成上述归属期首批1,905,000股限制性股票股份归属工作。上述股权激励落地事项，持续稳固核心激励机制有效性，充分调动激励对象工作积极性、稳固核心团队稳定性，长效绑定股东长远利益、公司经营发展利益与管理层及核心骨干个人利益，引导核心人员聚焦公司长期战略经营，持续提升公司经营发展质量与投资者回报水平。

六、 提升信披质量，加强与投资者的沟通

公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。

公司始终重视与广大投资者的交流互动，并致力于维护良好的投资者关系。公司将积极建立公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，通过投资

者热线电话、公司公开邮箱、上证e互动、分析师会议及业绩说明会等各种形式与投资者积极沟通，加深投资者对于公司经营情况的了解，增强投资者对公司的认同感，增进交流互信，树立市场信心。

2026年上半年，公司举办了2025年度业绩说明会、十五五·科技自立自强——科创板集成电路核心技术攻关之2025年度模拟芯片设计行业集体业绩说明会和2026年第一季度业绩说明会，通过线上线下等方式，累计接待170余人次券商、机构及个人的调研沟通或电话沟通。通过多种形式，加强与广大投资者的沟通，提高公司在资本市场的开放性，让投资者能够直接、全面、清晰地了解公司经营情况、发展现状等，增强投资者对公司的信心，努力夯实资本市场高质量发展基础。

七、 其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。2026年下半年，公司将继续专注主业，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

无锡芯朋微电子股份有限公司董事会

2026年8月13日